

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2024-012/013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	南方基金、平安资产、国泰基金、华安基金、广发基金、中欧基金、博道基金等。
时间	2024年8月29日-8月30日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长 Shumin Wang 总经理 Zhang Ming 副总经理、董事、董事会秘书 杨逊 法务及总经办副总监 厉吉超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍： 介绍公司经营情况及未来发展方向。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p>Q：公司未来2-3年的战略规划方向如何？</p> <p>A：公司始终坚持“立足中国，服务全球”的战略定位，持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务；进一步拓宽功能性湿电子化学品品类；在自主研发的基础上，引入电镀液及添加剂的国际合作，逐步覆盖多种产品品类。同时，在继续扩大国内市场份额的基础上，加大海外业务发展力度，加强投入和软硬件资源配置，积极加速海外市场拓展，进一步提高全球市场占有率，实现销售稳健增长。</p> <p>Q：公司在台湾地区的布局进展如何？</p> <p>A：台湾地区是公司战略发展布局的必经之地，也是公司“服务全球”版图的重要组成部分。公司正投入更多资源积极拓展中国台湾地区的市场，引进资深人才加强台湾团队建设和进行当地化布局两方面促进加快公司软硬能力的提升。</p>

Q: 公司未来拓展的新业务、新应用的策略是怎样的？进展如何？

A: 公司所处的领域具有“做专才能做强，做强才能做大”的特点，因此公司未来仍然会以所擅长的材料细分领域为主战场，同时密切关注与材料相关的相邻领域，采取“内生”加“外延”的策略，不断拓展新业务、新应用。目前公司在新领域、新应用、新产品的研发拓展方面取得显著成效，多个产品平台中的多款产品在成熟制程和先进制程的客户完成测试论证并实现量产销售，其中相当一部分产品作为首选供应获得订单；同时公司也在积极寻求外部合作机会，通过多元化的合作拓宽公司的业务领域，加强核心业务的竞争力，扩大整体规模。

Q: 海外客户对比国内客户，产品导入周期是否有所不同？

A: 由于所处地理位置和客户要求等因素不同，相应导入周期可能会有所不同，但大致流程是相似的。无论海外客户还是国内客户，公司都会努力缩短产品导入周期，积极配合客户需求。

Q: 公司研发研磨颗粒的原因及其进展如何？

A: 公司为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，因此公司建立并持续强化核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。目前参股公司开发的多款硅溶胶应用在公司多款抛光液产品中并实现量产销售；公司通过自研自建的方式持续加强了氧化铈颗粒的制备的自主可控能力，自产氧化铈磨料应用在公司产品中的测试论证进展顺利，多款产品已通过客户端的验证并实现量产供应，部分产品在重要客户实现销售，并有产品实现新技术路径的突破，显著提高客户良率。

Q: 公司功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂两方面对比抛光液处于什么发展阶段？

A: 功能性湿电子化学品相较于抛光液的客户群相对分散，且产品属性不同，目前在三个主要应用领域——逻辑芯片、存储芯片和先进封装中的产品都有不错增长；电镀液及添加剂由于特殊性质，验证周期在不同客户端会有所不同，因此增长并非线性，

目前先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售。

Q: 电镀液及添加剂产品验证情况如何，相较于友商有何优势？

A: 添加剂的研发生产在电镀液产品中具有相当难度，公司具备相应的研发及生产能力，且对其品质把控能力基本达到国际一流水平。目前，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售，产品包括铜、镍、镍铁、锡银等电镀液及添加剂，应用于凸点、重布线层（RDL）等技术；在集成电路制造领域，铜大马士革工艺及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂也按预期进展，进入测试论证阶段。

Q: 电镀液及添加剂的市场规模如何？相较于化学机械抛光液是否上量更快？

A: 电镀液及添加剂的总体市场规模大约是化学机械抛光液的一半，但目前阶段电镀液及添加剂的类别更少，集中度更高。由于不同于化学机械抛光液是过程性材料，电镀液及添加剂最终会留在晶圆上，因此客户在论证上量过程中会更加谨慎，公司又选择了晶圆级封装类的客户先导入，这样理论上可能稍慢于目前阶段的化学机械抛光液上量的周期。由于门槛高，一旦论证通过开始上量，被替代的可能性也更小，对公司来说是好事。

Q: 公司产品在国内市场是否面临价格压力？

A: 价格压力始终都会存在，作为一家知识产权为本、创新驱动的公司，加大研发投入，努力创新，为客户提供更具竞争力的产品和服务是公司的目标。提升客户的CoO，而非单纯的CoC，关注价值贡献，而非单纯的成本降低是公司的重点。

Q: 化学机械抛光液市场是否有成长空间？

A: 客户持续扩产所产生的增量需求以及市场变化产生的新技术、新应用将会给市场总量带来一定的成长贡献；同时，公司在国内市场的占有率仍然有不小的增长空间，在海外市场更是空间巨大。2023年，公司化学机械抛光液的全球市占率约为8%，根据TECHCET，2024年全球半导体CMP抛光材料（包括抛光液和抛光垫，其中抛光液占比近60%）市场规模将增长6%，公司将持续投入更多资源积极拓展国内及海外市场，提高市占率。

	<p>Q: 公司对于研发团队的管理是否随着人员规模扩大做出应对和改变?</p> <p>A: 公司始终坚持国际化、多元化的人才储备,对于研发团队的管理没有性质上的变化,随着人员和项目的增多,公司核心管理团队正在进一步增强资源调配、人才培养和团队建设。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月30日